



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090625000

2009 年 8 月 11 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP/HPA BGAパッケージ 一部製品 モールド樹脂変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site ☒ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	ASP/HPA BGA パッケージ 一部製品 モールド樹脂変更 現行：Cookson SMTB1/SMTB1-RC 変更後：Nitto HC100XJAA	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	11 月中旬の出荷より予定しています。 (サンプル出荷は、9 月中旬を予定しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト)及び HPA(ハイパフォーマンスアナログ) BGA パッケージ 一部製品について、現行 Cookson SMTB1/SMTB1-RC モールド樹脂を適用し製造しておりますが、Cookson SMTB1/SMTB1-RC モールド樹脂製造終了の為に、これに替わり、Nitro HC100XJAA に変更し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
モールド樹脂	Cookson SMTB1/SMTB1-RC	Nitto HC100XJAA

理由：Cookson SMTB1/SMTB1-RCモールド樹脂製造終了の為

対象製品リスト

対象製品名				
F312110AGFN	F721850GFN	TMS320C6711BGFN150	TNETV2011FNDGDS	TNETV2020AV1DGDS
F312259BGFN	F721971AGFN	TMS320C6711GFN100	TNETV2012AF1BGDS	TNETV2020AV1SGDS
F312514GFN	F731675GFN	TMS320C6711GFN150	TNETV2012AF1BWGDS	TNETV2020AV1SWGDS
F312604GFN	F731938AGFN	TMS320C6712GFN100	TNETV2012AF1DGDS	TNETV2020AVNDGDS
F312709GFT	F731953AGFT	TMS320C6211B1GFN150	TNETV2012AF1DWGDS	TNETV2021ACLGDS
F313100GFN	F731953GFT	TMS320C6211B1GFN167	TNETV2012AF1SGDS	TNETV2021AF1BGDS
F643056GFT	F741552GDC	TMS320C6211B1GFN180	TNETV2012AF1SWGDS	TNETV2021AF1BWGDS
F643969AGFT	F741759AGPJ	TMS320C6211BGFN150F	TNETV2012AFNBGDS	TNETV2021AF1DGDS
F643996AGFT	F741759AGPJ-W	TMS320C6211BGFN180H	TNETV2012AFNBWGDS	TNETV2021AF1DWGDS
F711014GFT	F741926AGFT	TMS320C6211BGFNA150	TNETV2012AFNDGDS	TNETV2021AF1SGDS
F711063AGFT	F741926BGFT	TMS320C6711BGFNA100	TNETV2012AFNDWGDS	TNETV2021AF1SWGDS
F711097GFW	GC2011A-PB	TNETC4310AGDS	TNETV2012AFNSGDS	TNETV2021AFNBGDS
F711130GFN	GC4016-PB	TNETC4320AGDS	TNETV2012AFNSWGDS	TNETV2021AFNBWGDS
F711168AGFN	GC4116-PB	TNETC43201AGDS	TNETV2012AGDS	TNETV2021AFNDGDS
F711277AGFT	TMP320AV7110GFN	TNETV2010AF1DGDS	TNETV2012AV1BGDS	TNETV2021AFNDWGDS
F711278GFT	TMP320AV7111GFN	TNETV2010AFNBGDS	TNETV2012AV1BWGDS	TNETV2021AFNSGDS
F711298GFT	TMP320AV7201GDS	TNETV2010AFNSWGDS	TNETV2012AV1DGDS	TNETV2021AFNSWGDS
F711315GFT	TMS320AV7110GFN	TNETV2010AGDS	TNETV2012AV1DWGDS	TNETV2021AGDS
F711345AGFN	TMS320AV7111GFN	TNETV2010AV1DGDS	TNETV2012AV1SGDS	TNETV2021AV1BGDS
F711353GFT	TMS320AV7200GDS	TNETV2010AV1DWGDS	TNETV2012AV1SWGDS	TNETV2021AV1BWGDS
F711369AGFT	TMS320AV7201GDS	TNETV2010AV1SGDS	TNETV2012AVNBGDS	TNETV2021AV1DGDS
F711374BGFN	TMS320C44GFW50	TNETV2010AVNDGDS	TNETV2012AVNBWGDS	TNETV2021AV1DWGDS
F711398BGF	TMS320C44GFW60	TNETV2010FNDGDS	TNETV2012AVNDGDS	TNETV2021AV1SGDS
F711413BGFN	TMS320C44GFWA	TNETV2011AF1DGDS	TNETV2012AVNDWGDS	TNETV2021AV1SWGDS
F711417AGFT	TMS320C6211BGFN150	TNETV2011AFNBGDS	TNETV2012AVNSGDS	TNETV2021AVNBGDS
F711443CGFT	TMS320C6211BGFN167	TNETV2011AFNDGDS	TNETV2012AVNSWGDS	TNETV2021AVNBWGDS
F711460AGFN	TMS320C6211BGFN180	TNETV2011AFNSWGDS	TNETV2020AF1DGDS	TNETV2021AVNDGDS
F711496GFN	TMS320C6211GFN150	TNETV2011AGDS	TNETV2020AFNBGDS	TNETV2021AVNDWGDS
F711975AGFT	TMS320C6211GFN167	TNETV2011AV1DGDS	TNETV2020AFNDGDS	TNETV2021AVNSGDS
F721582AGFN	TMS320C6211GFN180	TNETV2011AV1SGDS	TNETV2020AFNSWGDS	TNETV2021AVNSWGDS
F721600AGFN	TMS320C6711BGFN100	TNETV2011AVNDGDS	TNETV2020AGDS	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 3 月 1 日	終了	2009 年 6 月 30 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	F711928GFT	TMS320C44GFW50		
Die Size:	14.3x14.3mm	12.8x12.2mm		
Wafer Fab:	DM5	DM5		
Wafer Technology:	C12	C12		
Assembly Site:	AP3	AP3		
Package Type/Code/Pins:	PBGA/GFT/352	PBGA/GFW/388		
Mold Compound:	Nitto HC100XJAA	Nitto HC100XJAA		
Moisture Level:	JEDEC L-4/220C	JEDEC L-4/220C		
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Visual / Mechanical	per spec		45/0	
X-Ray	per spec		24/0	
Bond Pull	per spec		239/0	
Ball Bond Shear	per spec		239/0	
Manufacturability (Assembly)	per site spec		Approved	
UHaSt	130C,85%RH, 96hrs, 192hrs		240/0	
Temp Cycle	-55/125C, 1000cyc qual, 2000cyc info only		246/0	

信頼性試験結果

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 3 月 1 日	終了	2009 年 6 月 30 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device:	DaisyChain_352GFT (1)	Die Size:	14.3x14.3mm	
Wafer Fab:	DM5	Wafer Technology:	C12	
Assembly Site:	AP3	Package Type/Code/Pins:	PBGA/GFT/352	
Mold Compound:	Nitto HC100XJAA	Moisture Level:	JEDEC L-4/220C	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
BLR Temp Cycle	-40/125C ,1000cyc insitu		32/0	
Note:				
(1) Daisy chain is designed to provide a continuous path through the package for easy testing for board reliability.				